证券代码：603306　　证券简称：华懋科技　　公告编号：2026-088
债券代码：113677　　债券简称：华懋转债

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易变更签字会计师的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“华懋科技”或“公司”）于 2025 年 10 月 20 日向上海证券交易所提交了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的申请。2025 年 10 月 24 日，公司收到上海证券交易所出具的《关于受理华懋（厦门）新材料科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上证上审（并购重组）〔2025〕85 号）。

本次交易的审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙），本次变更前，审计报告的签字会计师为葛勤、刘田，现变更为刘桢、刘田。变更原因为：原审计报告签字会计师葛勤由于工作调整，不再负责拟购买资产的加期审计工作，故不再担任加期审计报告及相关报告的签字会计师。

具体内容详见公司于同日披露的《华懋科技关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易变更签字会计师的专项说明》《申港证券股份有限公司关于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目变更签字会计师的专项说明》《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于变更签字人员的承诺函》。

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 11 月 28 日